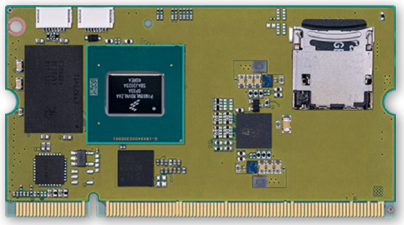
TRIZEPS SODIMM SOM

SOM-Trizeps-VIII-MX8M-Plus

NXP i.MX8M Plusアプリケーションプロセッサ搭載の
DIMM-200 CPU-モジュール

Arm®組み込みエッジソリューションに人工知能を導入



ハイライト

CPU
NXP i.MX8M プラス アプリケーション プロセッサー

コネクティビティ
2xギガビットイーサネット、2x USB 3.0、2x CAN-FD、PCIe、LVDS、2x MIPI-CSI、WiFi/Bluetooth

グラフィックス
マルチディスプレイ対応の統合GPU
GC520L 2Dアクセラレータ + GC7000UL 3Dアクセラレータ

メモリ
最大8GB LPDDR4-4000メモリ

工業用温度範囲で使用可能

GOLD PARTNER NXP

Windows 10 IoT debian yocto PROJECT android

主な適用分野

コーヒーと自販機 / メディカル / 交通機関 / 産業オートメーション / スマートデバイス / スマート電球とスマートシティ / デジタルサイネージ / エネルギーユーティリティ

特徴

プロセッサ	NXP i.MX 8M Plus ファミリ SoC:デュアルまたはクワッドArm® Cortex®-A53コア+汎用Cortex® M7 800MHzプロセッサ · NXP i.MX 8M Plus クワッド、最大1.8GHzのArm® Cortex®-A53コア x4 · NXP i.MX 8M Plus デュアル、最大1.8GHzのArm® Cortex®-A53コア x2 · NPU2.3 TOPSニューラルネットワークのパフォーマンス (Quad Lite非対応) オプション：NXP™Kinetis V Arm® Cortex-M0+ 最大75 MHz/8x 16ビットADC、UART、SPI、GPIO、I2C オプション：最大4300 LUTsのプログラマブルFPGA
メモリ	実装 LPDDR4-4000 メモリ、32 ビットインターフェース、最大8GB
グラフィック	統合グラフィックス・プロセッシング・ユニット GC7000UL、同時に3つの映像出力対応。 組み込み型VPU、HEVC/H.265、AVC/H.264、MPEG-4、MPEG-2、MVC、VC-1、RV、VP6、VP7、VP8、VP9、JPEG、HEVC/H.265、AVC/H.264のハードウェアエンコーディングのハードウェアデコードをサポート OpenVG 1.1、OpenGL ES 3.1、OpenCL 1.2 Full Profile、Vulkanに対応
動画インターフェース	HDMI®、MIPIディスプレイ (4チャンネル) /シングルまたはデュアルLVDS、LCD 24ビットRGB
動画解像度	HDMI®、LVDS、eDP：最大1920×1080p @60 動画デコーダー：1080p60、h.265/4、VP9、VP8 / 動画エンコーダー：1080p60、h.265/4
質量ストレージ	オンボード4ビット幅μSDカードソケットまたはオンボード8ビット幅eMMC
ネットワーキング	2x ガビットイーサネット (1x RGMII PHYと1x RGMIIインターフェース) オプション：WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MU-MIMO / Bluetooth 4.2/5.0
USB	2x USB 3.0 OTG
PCI-e	最大1つのPCI-e x1 Gen3ポート

オーディオ	デジタルだ：18x I2S TDM、DSD512、S/PDIF Tx + Rx、8チャンネルPDMマイク入力 アナログだ：ステレオヘッドフォン出力、モノラルスピーカー出力、ステレオライン入力、マイク入力
シリアルポート	4x UART
その他インターフェース	3x 4ビット幅SDIO 3.0 SPDIF入出力 I2S マルチチャンネルシリアルオーディオインターフェース 2x I2C スパイク QSPI GPIO PWM 2x CAN
電源供給	3.3V_{DC}
動作システム	Linux (Yocto) Linux Debian Android Windows 10 IoT
動作温度*	0 ÷ 70° C (消費者) -25 ～ 85° C (拡張コンシューマー) -40℃ ÷ 85℃ (産業用)
寸法	67.6 x 36.7 x 6.4 mm

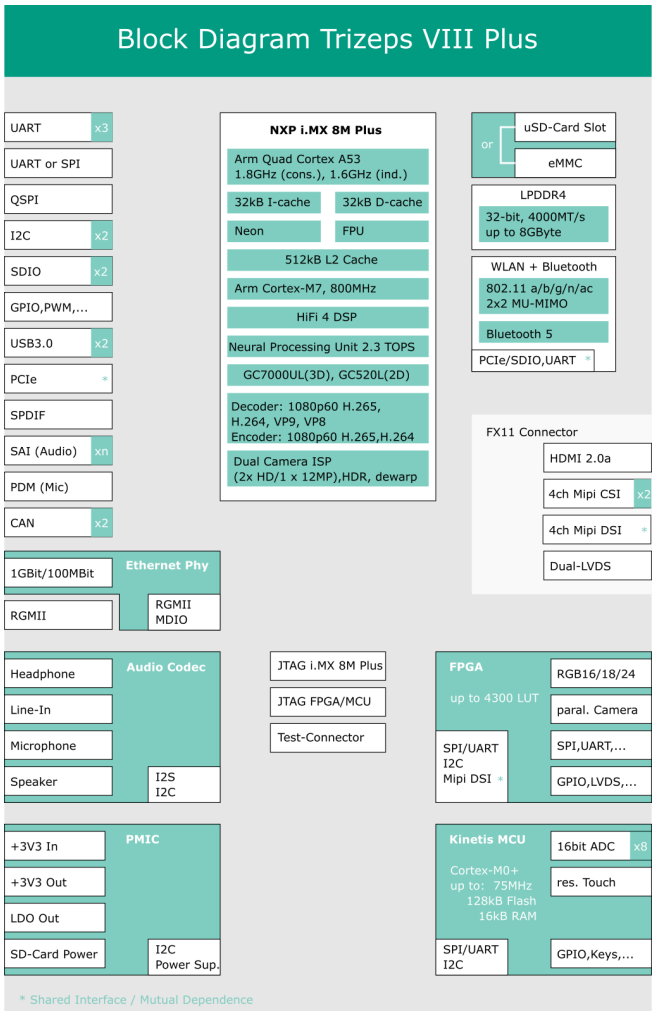
*すべてのキャリア ボードのコンポーネントは、起動を含め、常時動作温度内に留まる必要があります。キャリアの動作温度は、取り付けられているモジュールとは無関係です。詳細は各モジュールをご参照ください。実際の温度は、用途、筐体、および/または環境に大きく依存します。顧客は、最終的なシステムのための具体的な冷却ソリューションを検討します。

情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください

SOM-Trizeps-VIII-MX8M-Plus

NXP i.MX8M Plusアプリケーションプロセッサ搭載の
DIMM-200 CPU-モジュール

ブロック図



情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください

エッジコンピューティングの実装を合理化し、迅速化します

エッジホッグOS

カスタマイズツールとDockerのサポートにより、ニーズに適応する柔軟なオペレーティングシステムです。信頼性とセキュリティは、デュアルパーティションシステムとExeinの堅牢なAIベースの保護とのネイティブ統合によって組み込まれています。

デバイスマネージャー

更新、設定、またリモートデバイスを管理します。コストのかかる現場介入を必要とせずに、運用効率とセキュリティを最大化するために時間とコストを最適化します。

データオーケストレーション

サードパーティのサービスを統合し、データフローと分析を簡素化し、AI を簡単かつ迅速に利用できるようにするのでビジネス効率を高めます。

ポータル

リモートデバイスからのデータを分析し、ユーザーのニーズに合わせたアプリケーションでユーザーエクスペリエンスをカスタマイズし、ユーザー権限、企業アクセス、テナント権限を管理します。



スキャンして詳細を確認してください
ソリューション

エッジホッグOS

CLEA DOCS

情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください